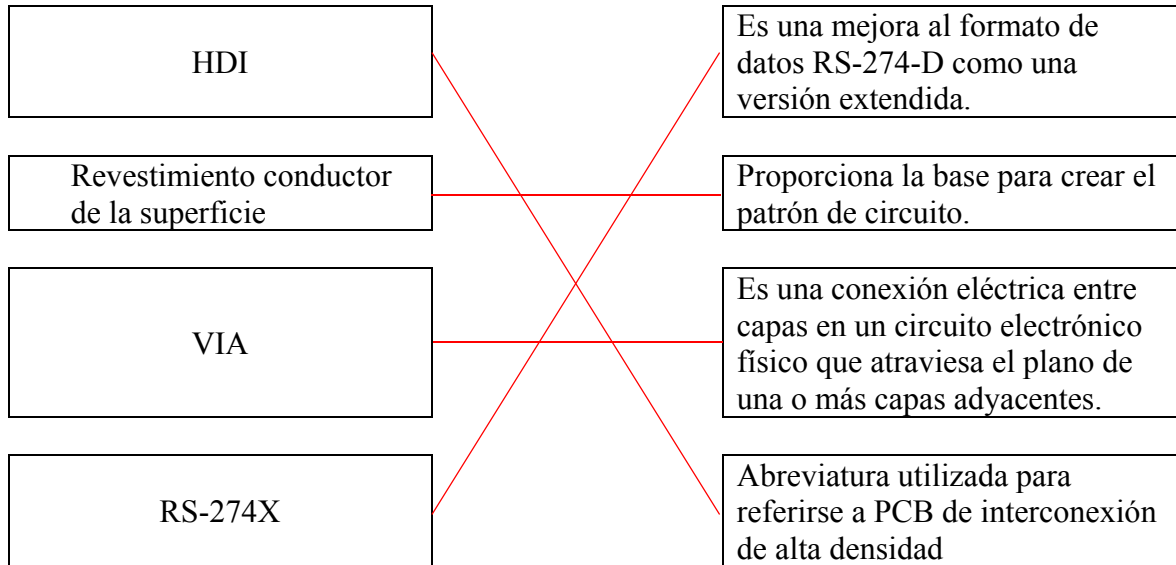


1. Asigne los términos de la columna izquierda a las definiciones correspondientes a la derecha.



2. Enumere tres características básicas de las placas de circuito impreso de interconexión de alta densidad.

1. Mayor densidad de cableado por unidad de área que las PCB convencionales.
2. Tienen líneas y espacios más finos.
3. Tienen vías más pequeñas, pads de captura y una densidad de pads de conexión muy alta.

3. Corrija el texto para que las siguientes afirmaciones sean ciertas.

Los pines de la fuente de alimentación se deben desacoplar directamente del plano de tierra mediante el uso de (~~inductancias~~ **condensadores cerámicos**) lo más cerca posible de los pines de alimentación del circuito integrado.

En general, frecuencias superiores a 1GHz (~~1 MHz~~ **1 GHz**) son consideradas altas frecuencias.

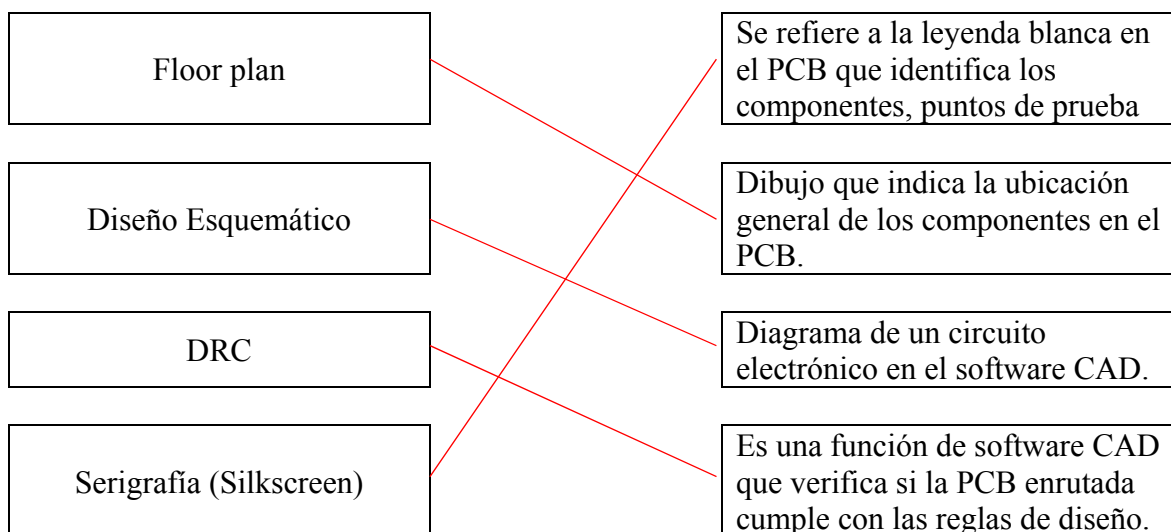
Los PCBs de una capa son fabricados de un sola capa de (~~material base o substrato~~ **resina**).

Las PCB con respaldo de aluminio : Aluminum backed PCBs, se componen de un refuerzo de (~~Al~~ **Au**) una capa dieléctrica altamente conductora térmicamente y una capa de circuito estándar.

Las PCB rigid-flex, combinan lo (~~peor~~ **mejor**) de las placas rígidas y flexibles integradas juntas.



4. Asigne los términos de la columna izquierda a las definiciones correspondientes a la derecha.



5. Enumere un mínimo de 5 pasos básicos del proceso de fabricación de PCB.

1. Film generation
2. Perforación
3. Proceso de grabado (Etching)
4. Máscara de soldadura
5. Serigrafía



6. Corrige el texto para que las siguientes afirmaciones sean ciertas.

Mantener las masas digitales y analógicas (~~juntas~~ **separadas**) porque los picos de tensión y los de corriente desde circuitos (~~analog~~ **digital**) pueden generar ruido de interferencia en los circuitos (~~digitales~~ **analógicos**).

Al ubicar los componenetes, (~~maximizar~~ **minimizar**) las distancias y evitar ángulos de (~~45~~ **90**) grados.

Los fabricantes utilizan un (~~impresora~~ **plotter óptico**) para obtener una imagen (~~digital~~ **negative**) del PCB.

Las señales sensibles deben ser (~~mantenidas aparte~~ **blindadas**) de las fuentes de ruido con planos y debe realizarse un control de impedancia.

